



导电银胶

EG-4101

1.介绍

1 是一款柔性的导电银胶，具有低应力、高导电、高导热等特点，对大多数 CTE 不匹配的基材具有出色的粘接力，可适用于陶瓷、铜或铝基板上的大面积芯片/基材粘接。

1 在 80-100°C 的温度下可进行返工。

2.特征

- 1) 低应力；
- 2) 高导电；
- 3) 高粘接性；

3.一般特性

试验项目	单位	代表值	测定方法
外观	-	银色膏状	目视
粘度 (25°C)	cp	50000	Brookfield 粘度计, 5rpm
密度	g/cm ³	5.20	比重杯
操作时间 (25°C)	hour	12	-
硬度 (Shore A)	-	90	邵氏硬度计
粘接强度	MPa	>12	推力机
连续工作最高温度	°C	200	-
玻璃化转变温度	°C	-	DSC
线性热膨胀系数	ppm/°C	-	TMA
热传导率	W/m•K	7.0	激光导热仪
介电强度	kV/mm	-	耐压测试仪
体积电阻率	ohm-cm	<2×10 ⁻⁴	电阻测试仪

4.标准固化条件

推荐：150°C×60min；具体的固化方案客户可根据实际应用进行调整。

5.注意事项

- 1) 未开封包装在-40°C下的保质期为 12 个月；
- 2) 应被冷冻运输和存储直到被使用；
- 3) 使用前应将胶黏剂在环境温度下解冻回温，时间应不少于 60 分钟；
- 4) 施胶前将针筒外壁水汽擦拭干净，施胶时应保持基板洁净以达到最佳的粘接性能。

上海费尔德新材料有限公司

总部电话：+86-21-61739388 销售热线：4001066285

总部地址：上海市松江区文松路 333 弄 1 号楼 102 室

溧阳工厂：溧阳市费尔德电子材料有限公司

地址：江苏省常州市溧阳市戴埠镇山口村 88 号

注意：以上列出的数据是典型值，不用于制定规范，仅供参考。